

## 南茂科技ChipMOS

南茂科技是在半导体封装测试领域中具领先地位的公司，其中显示器驱动IC封装测试产能位居全世界前列，其服务的对象包括半导体设计公司、整合元件制造公司、及半导体晶圆厂。南茂科技于2014年4月在台湾证券交易所挂牌上市（股票代码：8150），并于2016年10月合并其母公司百慕达南茂科技，同时于同年11月在美国那斯达克股票市场发行美国存托凭证，股票代码为IMOS。

南茂科技不仅为客户提供记忆体半导体及混合讯号产品多元化的后段测试服务，近几年来对于显示器驱动积体电路产品也是积极地扩大产能和增加技术服务项目。南茂科技在记忆体半导体、混合讯号及显示器驱动积体电路等产品的封装技术服务，提供包括导线架及有机基板等多样化技术的选择。这些产品主要应用于个人用电脑、通讯设备、办公室自动化及消费性电子产品等等。

目前，主要的测试与封装的设备机台皆安置于台湾的两大科学园区内；新竹科学园区的工厂是以测试服务为主，而南部科学园区的生产线则是以封装服务为主。同时，南茂科技也在新竹县竹北和湖口地区的工厂提供晶圆凸块和晶圆测试的服务，透过这样的安排不但能够充份发挥测试及封装技术服务各自独立作业的功能，更可整合技术资源提供一系列完整的全程服务。除了提供半导体后段制程服务外，南茂科技也与全球的客户合作，透过在全球的营运据点，提供全球客户垂直整合的、完整的半导体制程服务。

南茂科技运用先进的技术及研发热忱，规划技术蓝图并了解客户需求，及时抓住与客户同步成长的机会。而南茂科技在技术研发上的努力，则可协助客户增加营运效率，并减少营运成本。

本文链接：<https://dqcm.net/wenan/nlkjchip-14582.html>